

聯茂電子

2025年第三季投資人簡報

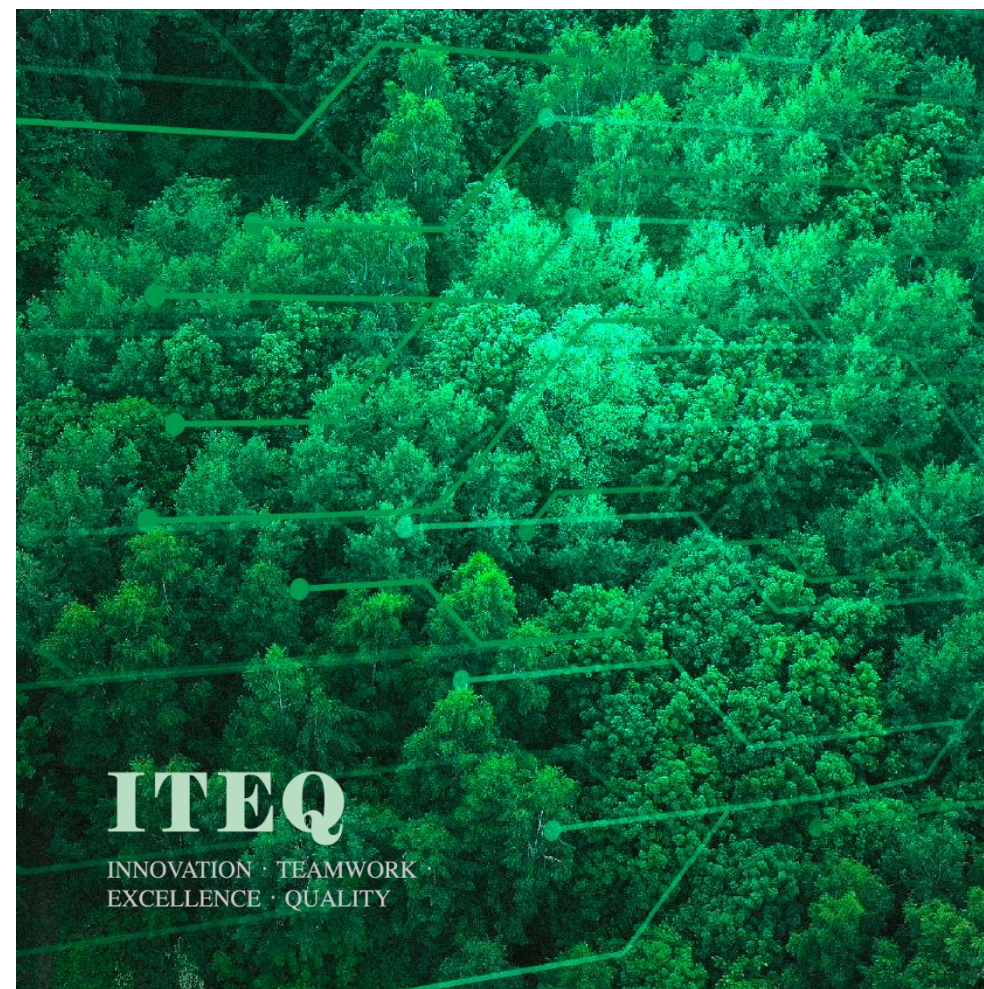
ITEQ

INNOVATION. TEAMWORK. EXCELLENCE. QUALITY

Nov 2025

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊，其中包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。



公司簡介



成立日期
1997年4月10日



總部
臺灣新竹縣



實收資本額
NT\$ 36.3億



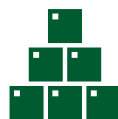
員工
約4,000人



董事長
陳進財

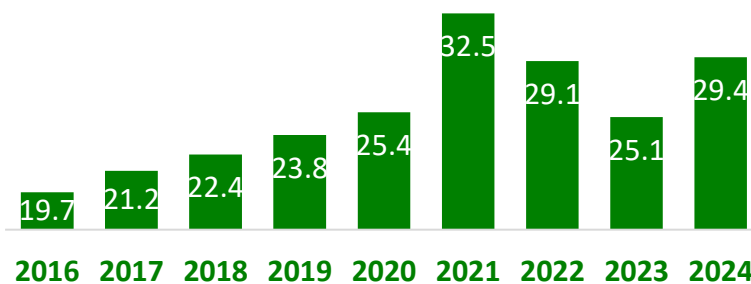


執行長
蔡馨曄

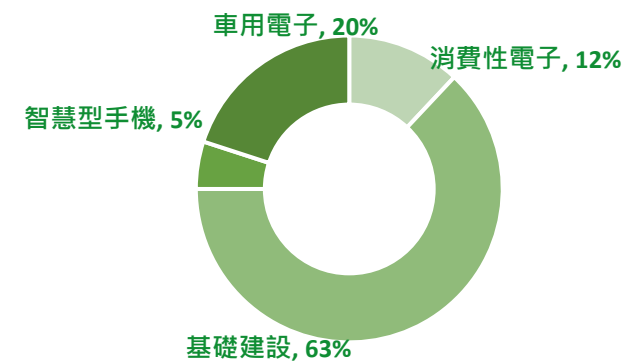


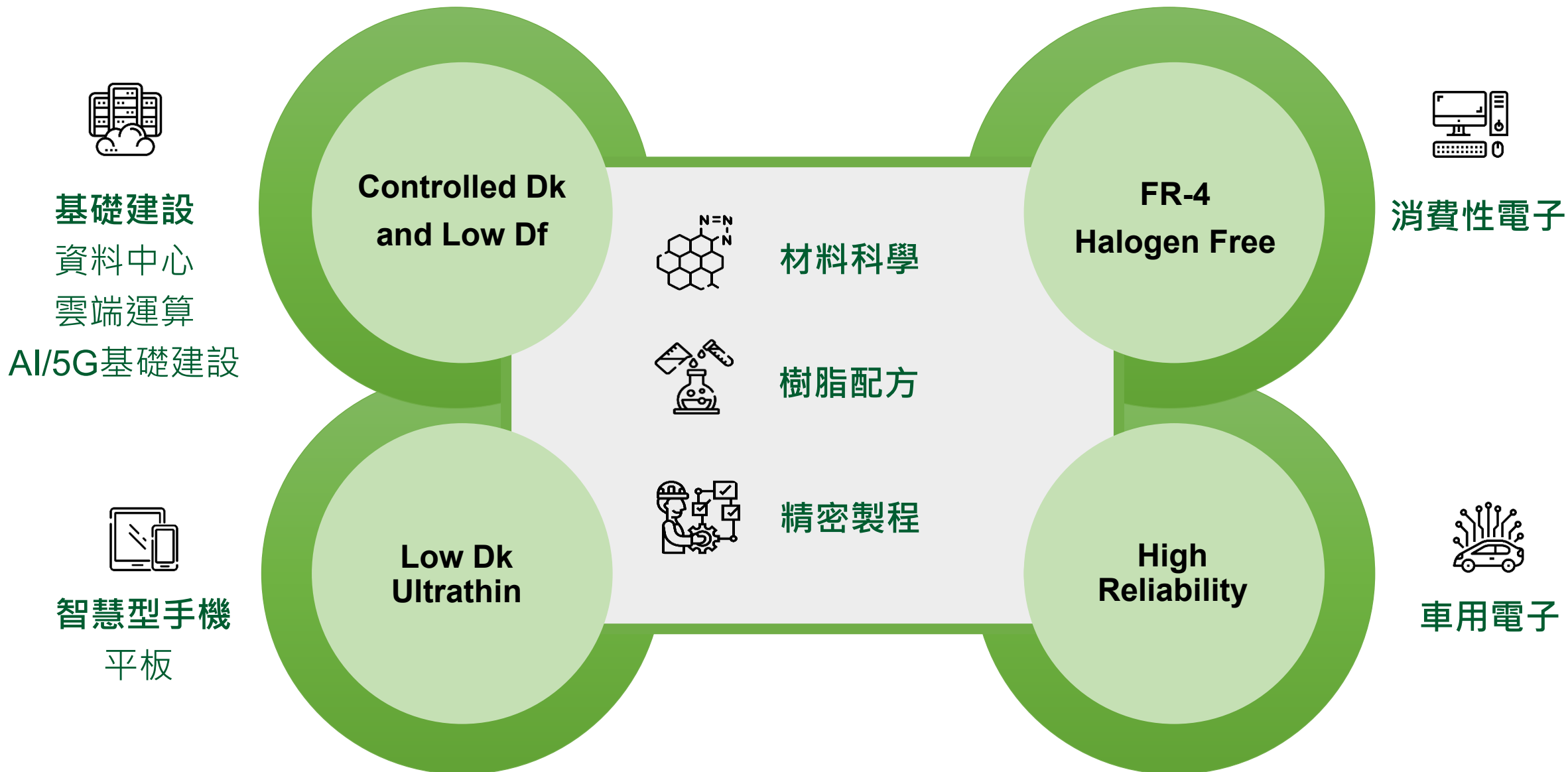
主要產品
銅箔基板 (CCL) & 膠片 (PP) | 多層壓合代工 | 軟性銅箔基板

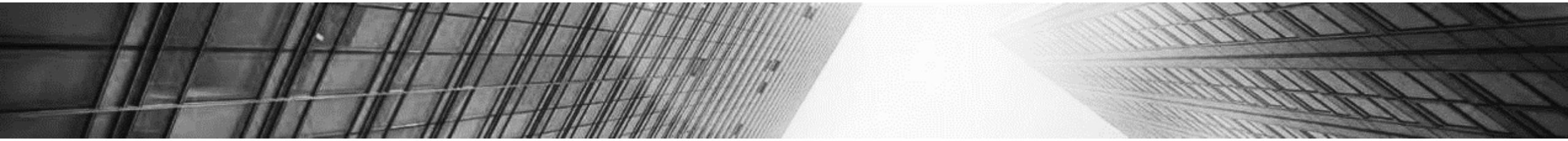
營收 (NT\$ 十億元)



產品應用別營收 (2024全年)







成長策略藍圖

ITEQ

ITEQ

INNOVATION • TEAMWORK •
EXCELLENCE • QUALITY

廣泛應用於消費性
電子產品



導入車用銅箔基板於
知名國際廠商



提供智慧型手機應
用之銅箔基板



提供伺服器應用之
銅箔基板



成為Intel Purley伺
服器平台主要銅箔
基板供應商



台灣最大5G基地台
應用之銅箔基板供應
商



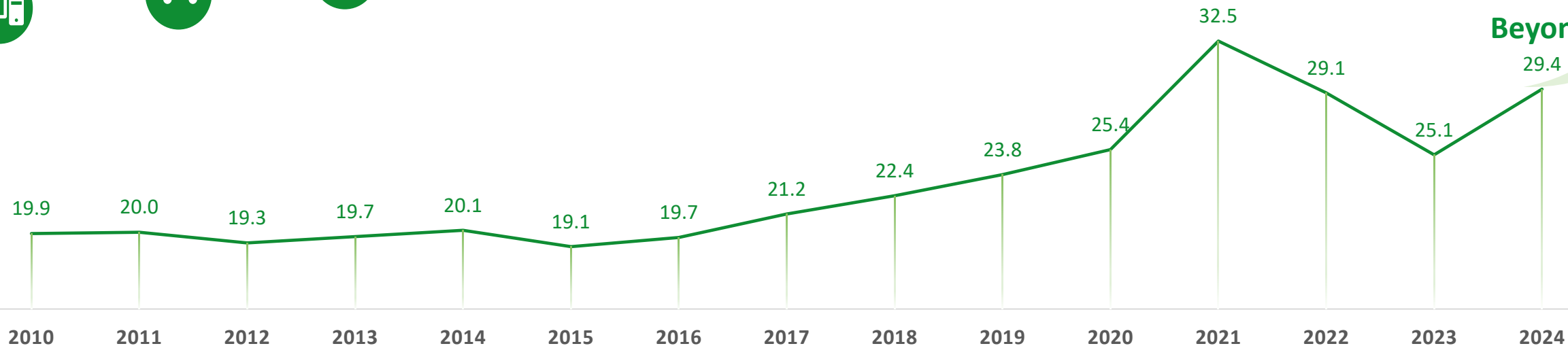
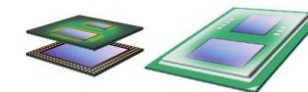
新產品發表 (次世代 HDI
PCB應用): 背膠銅箔 (RCC)



AI應用高速材料

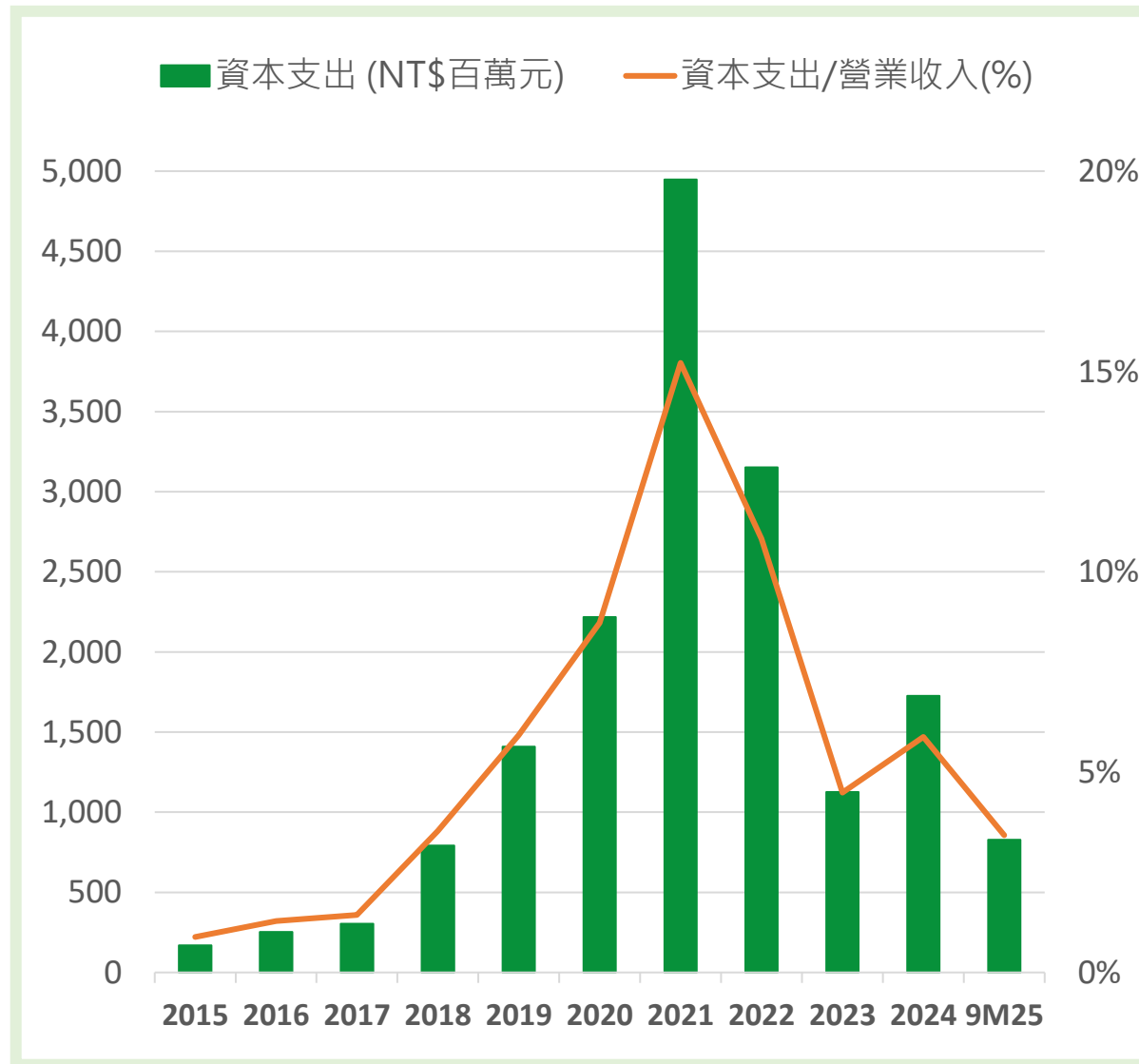
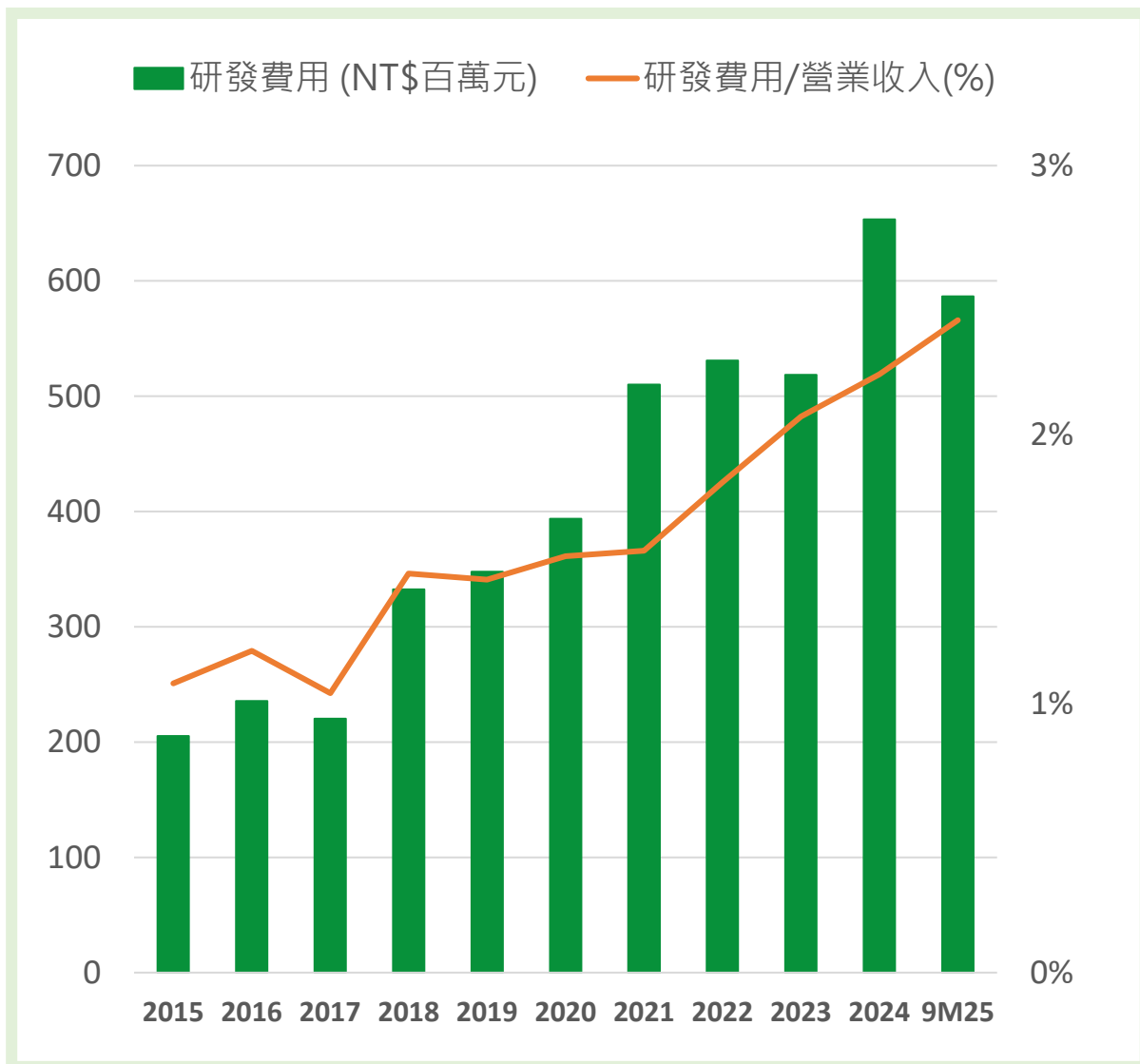


類載板基材 (SLP)
IC封裝載板基材

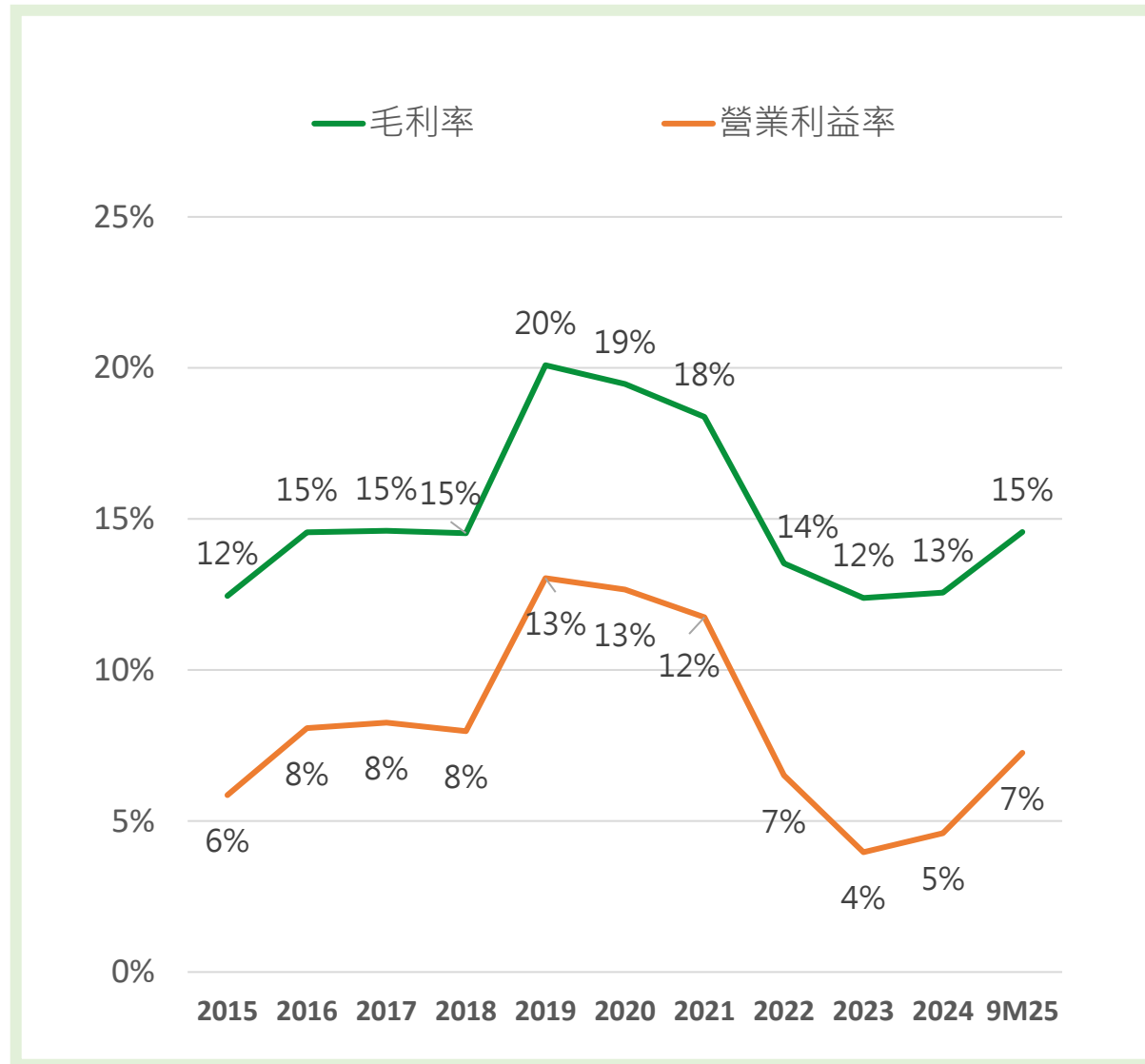
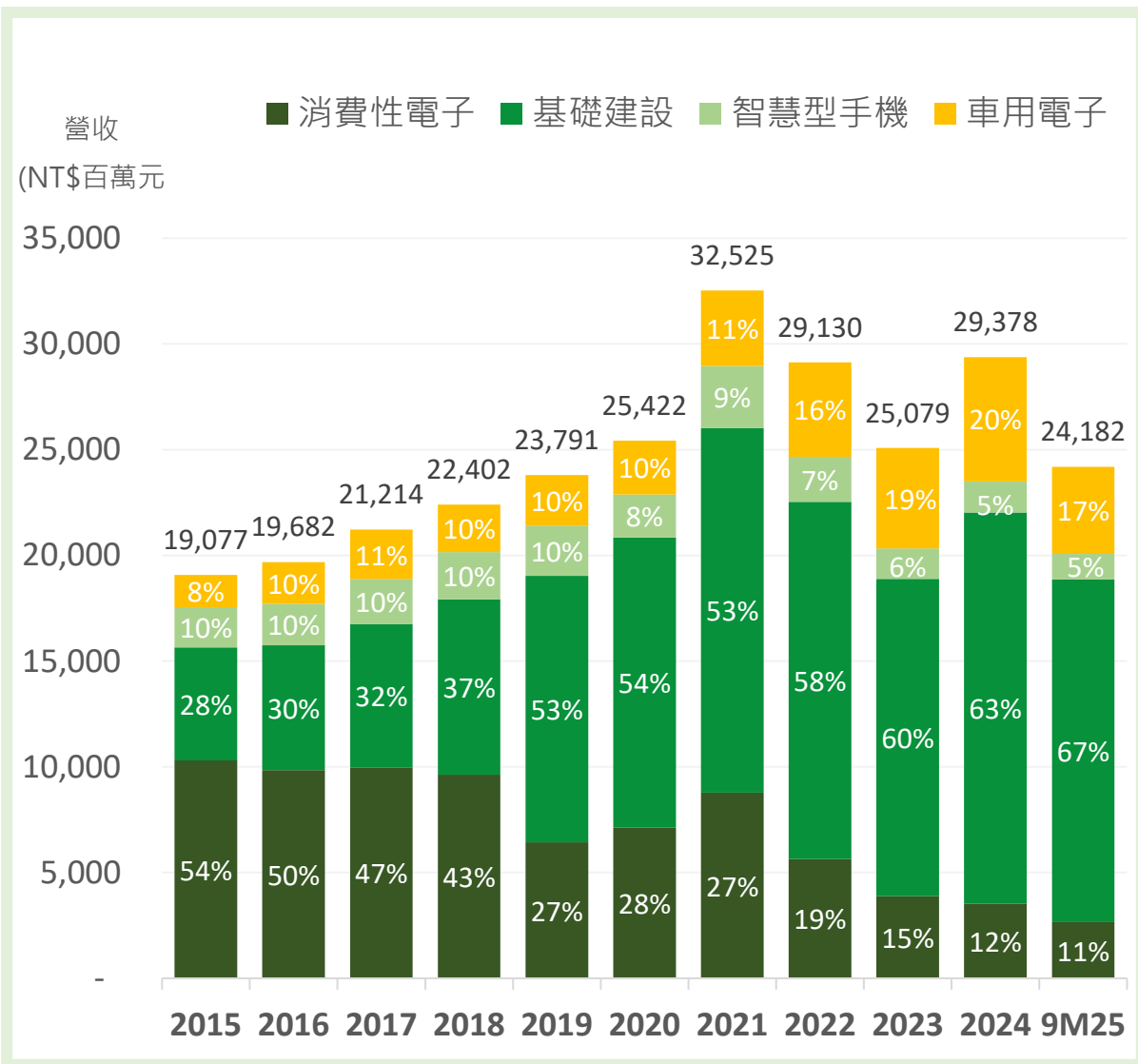


— 營收 (NT\$ 十億元)

永續成長 - 投入研發與資本支出

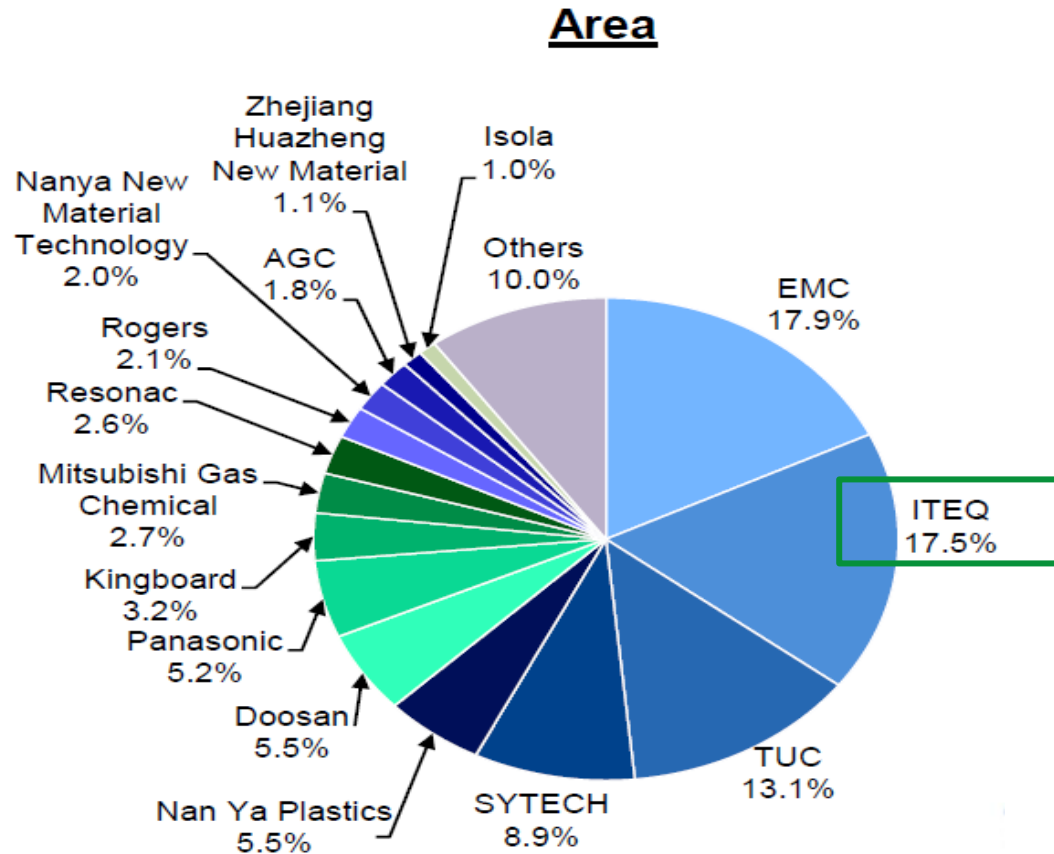


*9M25資本支出包含預付設備款增加約NT\$5.83億元



2024年全球特殊基板供應商市佔率

聯茂：銅箔基板領先供應商



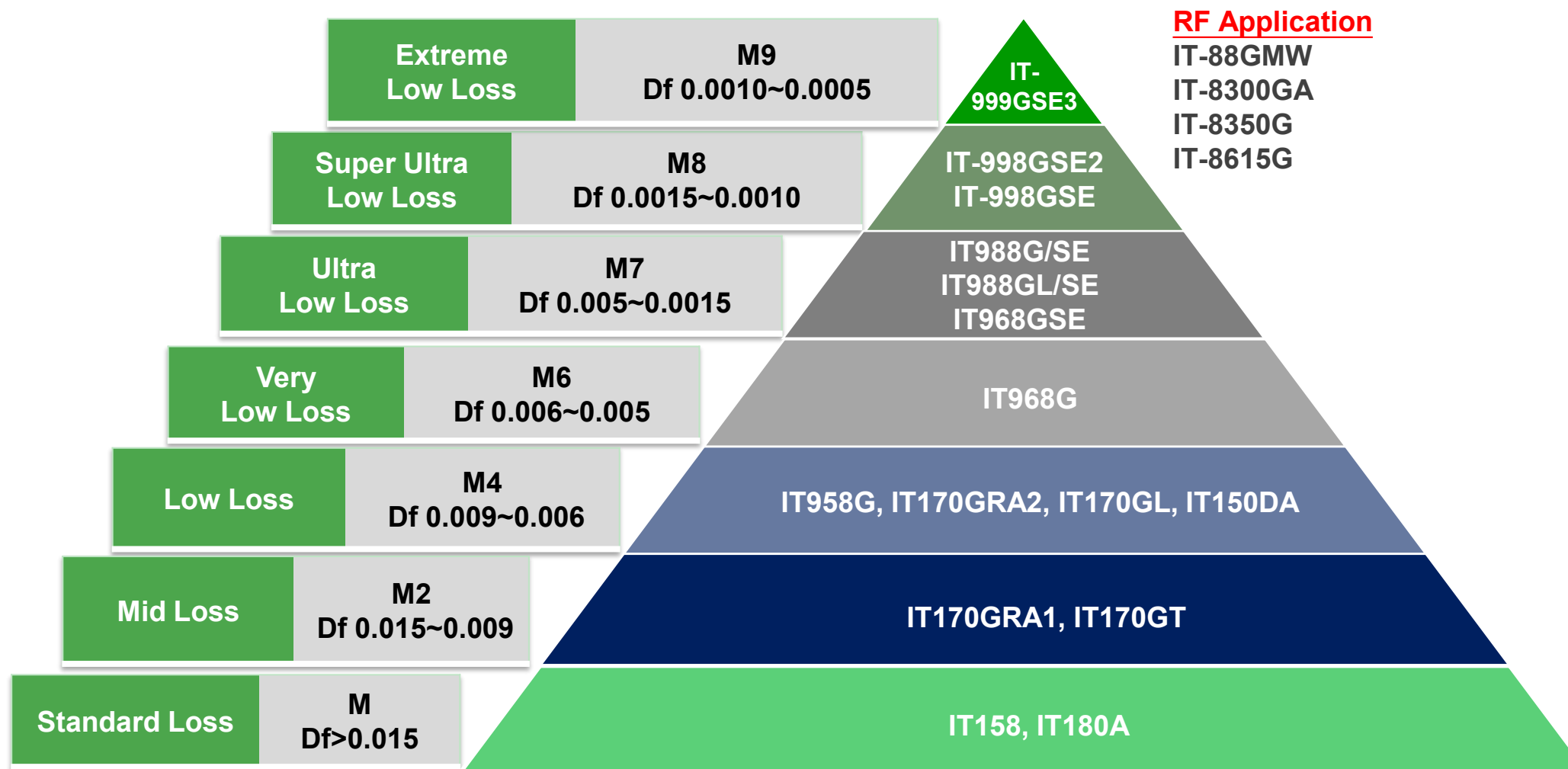
TOTAL: 142.0M m²

- 全球高速高頻銅箔基板主要供應商
- 先進製程技術和豐富量產經驗
- 網通基礎建設與高速運算資料中心升級商機之長期受惠者
- 全球車市電氣化趨勢擴大車用電子對高速高頻材料需求

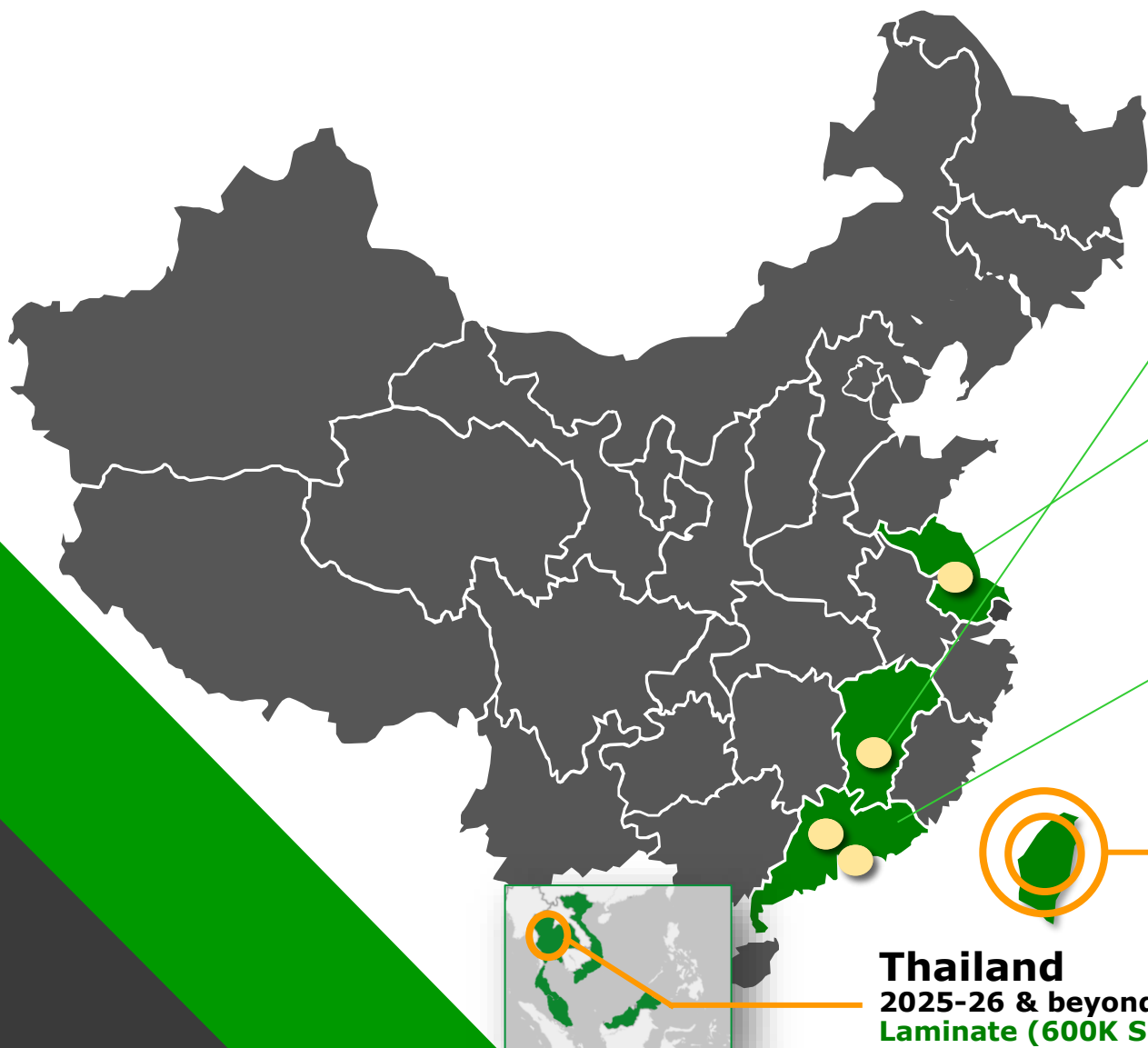
ITEQ

INNOVATION · TEAMWORK ·
EXCELLENCE · QUALITY

*特殊基板包含：高速基板、封裝基板、射頻基板
資料來源：Prismark Report, 2025/06



- 隨著高速運算資料中心、AI伺服器升級等需求，帶動高頻高速材料需求高度成長。
- ITEQ在高頻高速材料市場的市占率將顯著提升。



JiangXi Plant
Since 2019
Laminate (2,400K SHT/Month)
Prepreg (6,000K M² /Month)



WuXi Plant
Laminate (1,650K SHT/Month)
Prepreg (4,000K M² /Month)



DongGuan Plant
Laminate (450K SHT/Month)
Prepreg (1,500K M² /Month)



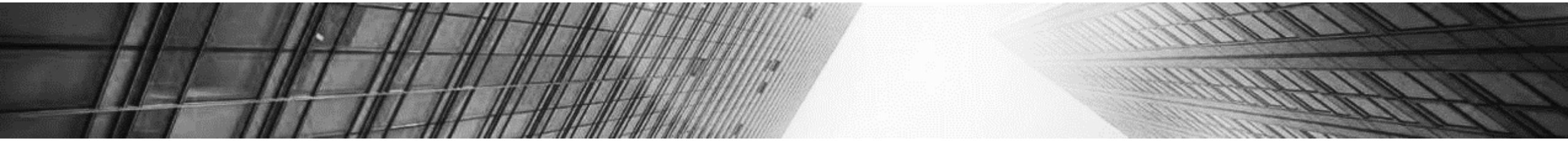
GuangZhou Plant
FCCL (1,150K M²/Month)



HsinChu (Headquarters)
Laminate (600K SHT/Month)
Prepreg (1,500K M/Month)

Thailand
2025-26 & beyond
Laminate (600K SHT/Month)
Prepreg (TBD)

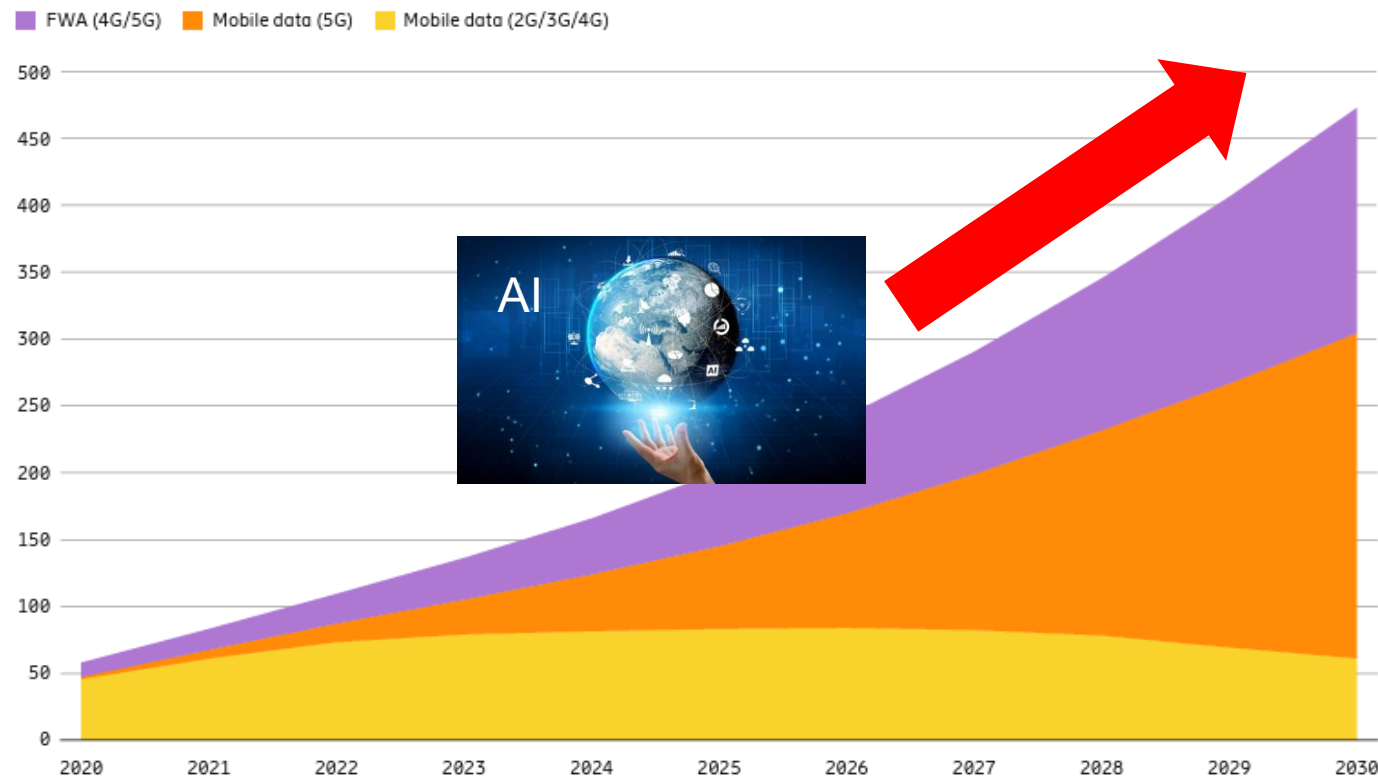
Distributor/Agent: USA, Europe, Israel, Korea, Japan and Singapore



市場趨勢 & 成長動能

ITEQ

全球行動網路數據流量 (EB/月)



資料來源：Ericsson Mobility Report, 2024/11

● 全球網路數據加速擴增

- AI & 高效能運算 & 大數據分析
 - 邊緣運算 (企業強化版基礎建設，如公司機房 & 廠內外伺服器、訊號發射站等等)
- 電信設備 & 資料中心
 - 基地台、地面衛星收發站
 - 核心 (傳統 / 雲端資料中心)
- 雲端運算與雲端儲存
- 車聯網 (ADAS & 自駕車)
- 終端 (電腦、智慧型手機、IoT 裝置)
- 物聯網相關應用 (智慧家庭 & 遠端醫療)
- 虛擬實境 (VR) 與擴增實境 (AR)

- 全球行動數據流量大幅提升，帶動雲端服務供應商 (CSP) & 電信商以及各類物聯網 & 車聯網廠商擴增/提升產品規格來滿足低延遲、高可靠與高速運算處理需求
- 全球伺服器市場未來將穩健成長
 - 生成式 AI 應用將同時驅動 AI 伺服器與通用型伺服器需求
 - AI 伺服器需求持續推升 CCL 產值

資料中心伺服器平台持續升級

Intel	Platform	Purley		Whitley	Eagle Stream		Birch Stream	Oak Stream
	CPU	Skylake	Cascade Lake	Ice lake	Sapphire Rapids	Emerald Rapids	Granite Rapids	Diamond Rapids
	Nano Process	14 nm	14 nm+	10 nm	Intel 7	Intel 7	Intel 3	Intel 18A
	PCIe Gen	PCIe 3.0	PCIe 3.0	PCIe 4.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 6.0
	MP Time	2017 Q3	2019 Q3	2021 Q1	2023 H1	2023 H2	2024	2026
	CCL Material	Mid Loss	Mid Loss	Low Loss	Very Low Loss	Very Low Loss	VLL/ Ultra Low Loss	Ultra Low Loss
	Layer count	8 to 12	8 to 12	12 to 16	16 to 20	16 to 20	18 to 22	20 to 24

AMD	Architecture	Zen	Zen2	Zen3	Zen4		Zen5	Zen6
	CPU	Naples	Rome	Milan	Genoa	Bergamo	Turin	Venice
	Nano Process	14 nm (Global Foundries)	7 nm (TSMC)	7 nm (TSMC)	5 nm (TSMC)	5 nm (TSMC)	4 nm / 3 nm (TSMC)	2 nm (TSMC)
	PCIe Gen	PCIe 3.0	PCIe 4.0	PCIe 4.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 6.0
	MP Time	2017 Q3	2019 Q3	2020 Q4	2022 Q4	2023	2024	2026
	CCL Material	Mid Loss	Low Loss	Low Loss	Very Low Loss	Very Low Loss	VLL/ Ultra Low Loss	Ultra Low Loss
	Layer count	8 to 12	12 to 16	12 to 16	16 to 20	16 to 20	18 to 22	20 to 24



資料中心長期穩定升級將有利予以下；

- 對應設備之基板材料亦同等升規
- 增加銅箔基板消耗量與設計板層數

綠能/電動車



- 節能
- 大電流
- 充電
- 大電壓
- 厚銅

High Tg 材料

車聯網

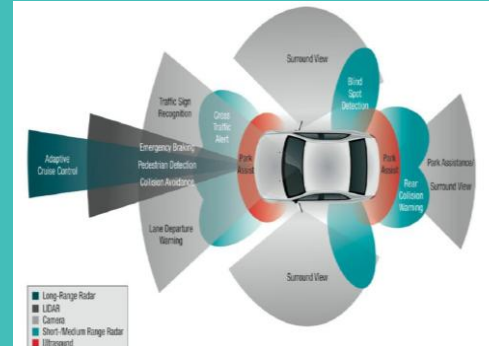


- 車用資訊娛樂
- 網路通訊

HDI 材料

高速材料

主動式安全系統



- 安全駕駛系統
- ADAS (先進駕駛輔助系統)
- 雷達
- 天線模組

HDI 材料

高速材料

高頻材料

自動駕駛

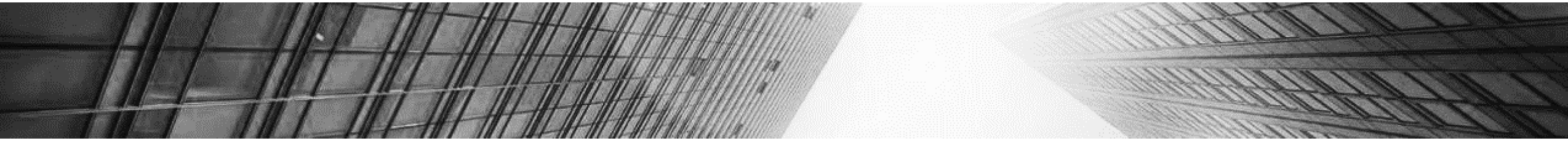


- 車用高速運算
- 影像處理計算
- 自主駕駛控制平台模組

HDI 材料

高速材料

- 電動車、車聯網和主動式安全駕駛系統將推動高性能車用銅箔基板之需求
- 電動車用PCB為傳統燃油車的四至五倍



3Q25 營運成果

ITEQ

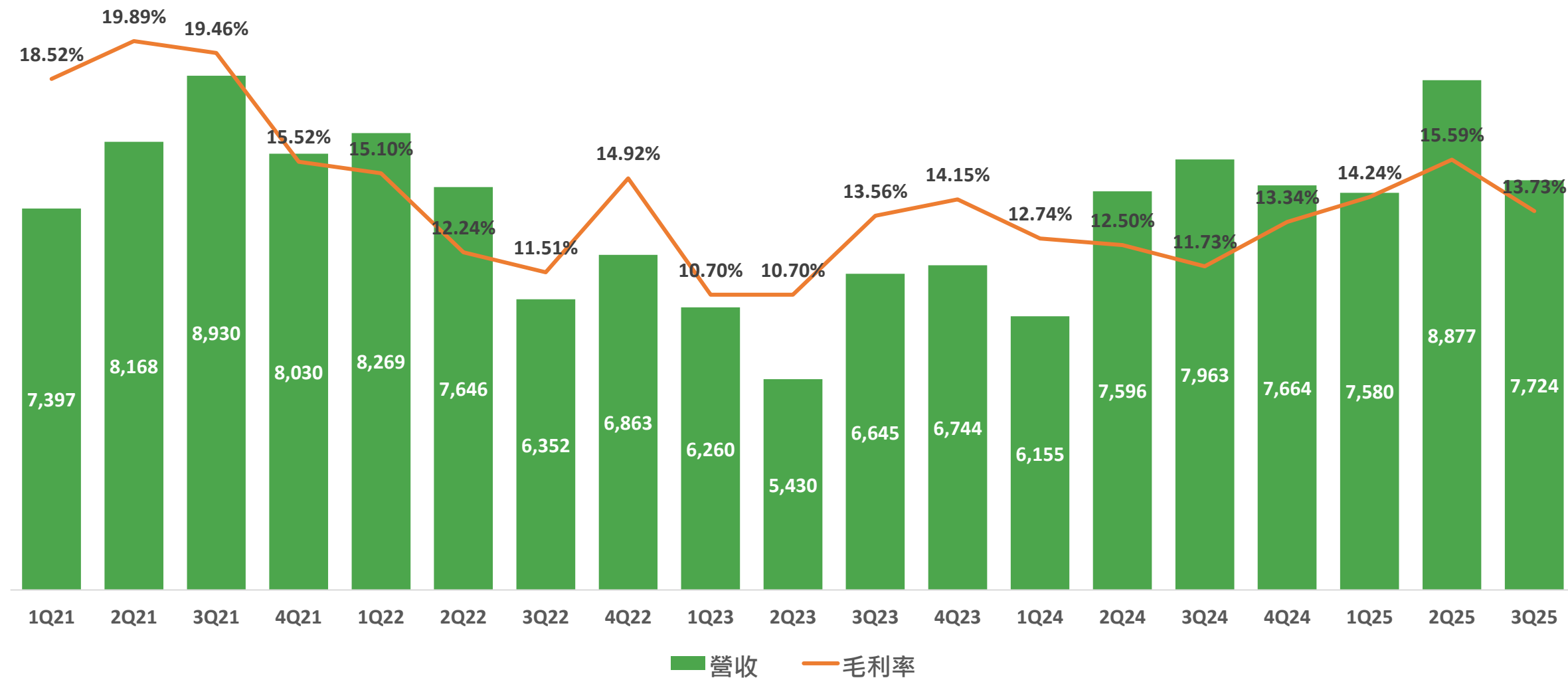
3Q25 損益表

NTD/百萬元	3Q25	2Q25	3Q24	QoQ	YoY
營業收入	7,724	8,877	7,963	-13.0%	-3.0%
營業毛利	1,061	1,384	934	-23.3%	13.6%
營業費用	615	596	554	3.2%	11.0%
營業利益	446	788	380	-43.4%	17.4%
營業外收入及支出	75	(118)	37		
稅前淨利	521	670	417	-22.2%	24.9%
所得稅費用	196	250	168		
歸屬於母公司之淨利	325	420	249	-22.6%	30.5%
每股盈餘(NTD)	0.89	1.16	0.69	-23.3%	29.0%
重要財務比率					
毛利率	13.7%	15.6%	11.7%		
營業費用率	8.0%	6.7%	7.0%		
營業利益率	5.8%	8.9%	4.8%		
有效稅率	37.6%	37.3%	40.3%		
淨利率	4.2%	4.7%	3.1%		

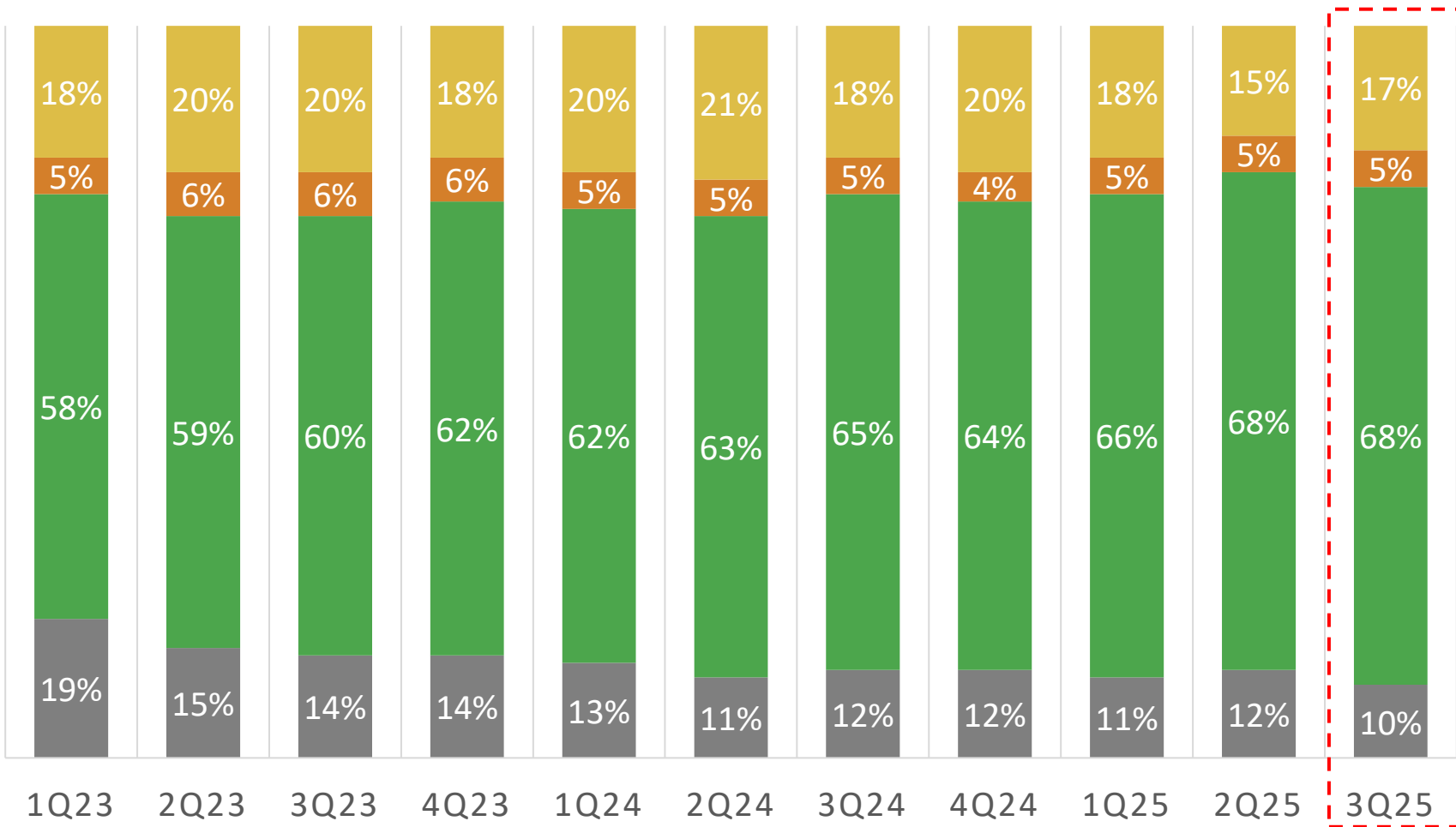
NTD/百萬元	3Q25	2Q25	3Q24
資產總額	34,734	34,940	36,408
現金及約當現金	4,541	3,348	5,273
應收帳款/票據	13,344	13,537	12,909
存貨	4,298	4,285	4,308
固定資產	9,183	8,858	9,271
負債總額	14,999	16,552	15,983
短期借款	3,451	4,038	4,545
應付帳款/票據	7,451	8,000	7,392
長期借款	1,756	1,496	1,742
股東權益總額	19,735	18,387	20,426
重要財務指標			
應收帳款週轉天數	150	150	157
存貨週轉天數	60	58	60
應付帳款週轉天數	92	94	98
股東權益報酬率(年化)(%)	6.4	6.3	4.7
資產報酬率(%)	4.3	3.9	3.0
負債比(%)	43.2	47.4	43.9

營收 & 毛利率

(百萬 NTD)



■ 消費性電子
 ■ 基礎建設
 ■ 智慧型手機
 ■ 汽車電子



3Q25 產品成長率	QoQ	YoY
汽車電子	-1.4%	-8.4%
智慧型手機	-13.0%	-3.0%
基礎建設	-13.0%	+1.5%
消費性電子	-27.5%	-19.2%

年度	每股盈餘(NT\$)	股利(NT\$)	現金股利(NT\$)	配息率(%)
2019	8.13	5.0	5.0	62%
2020	8.19	5.0	5.0	61%
2021	9.00	5.0	5.0	56%
2022	4.94	3.0	3.0	61%
2023	1.86	1.5	1.5	81%
2024	2.26	1.8	1.8	80%

*於2020年3月31日完成現金增資發行新股3千萬股

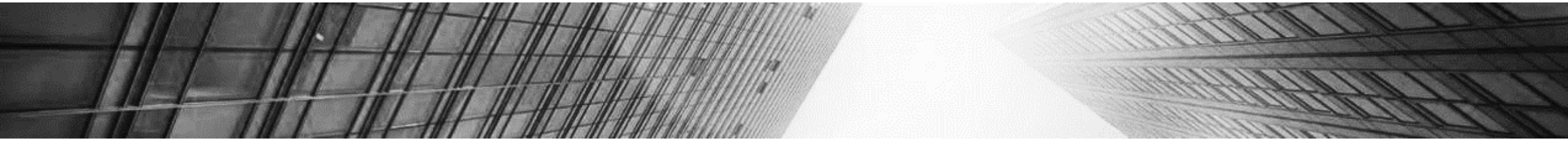
**於2021年9月2日完成現金增資發行新股5千萬股

***計入3Q22庫藏股買回與註銷2千萬股；目前普通股數約為3.63億股



Thank you

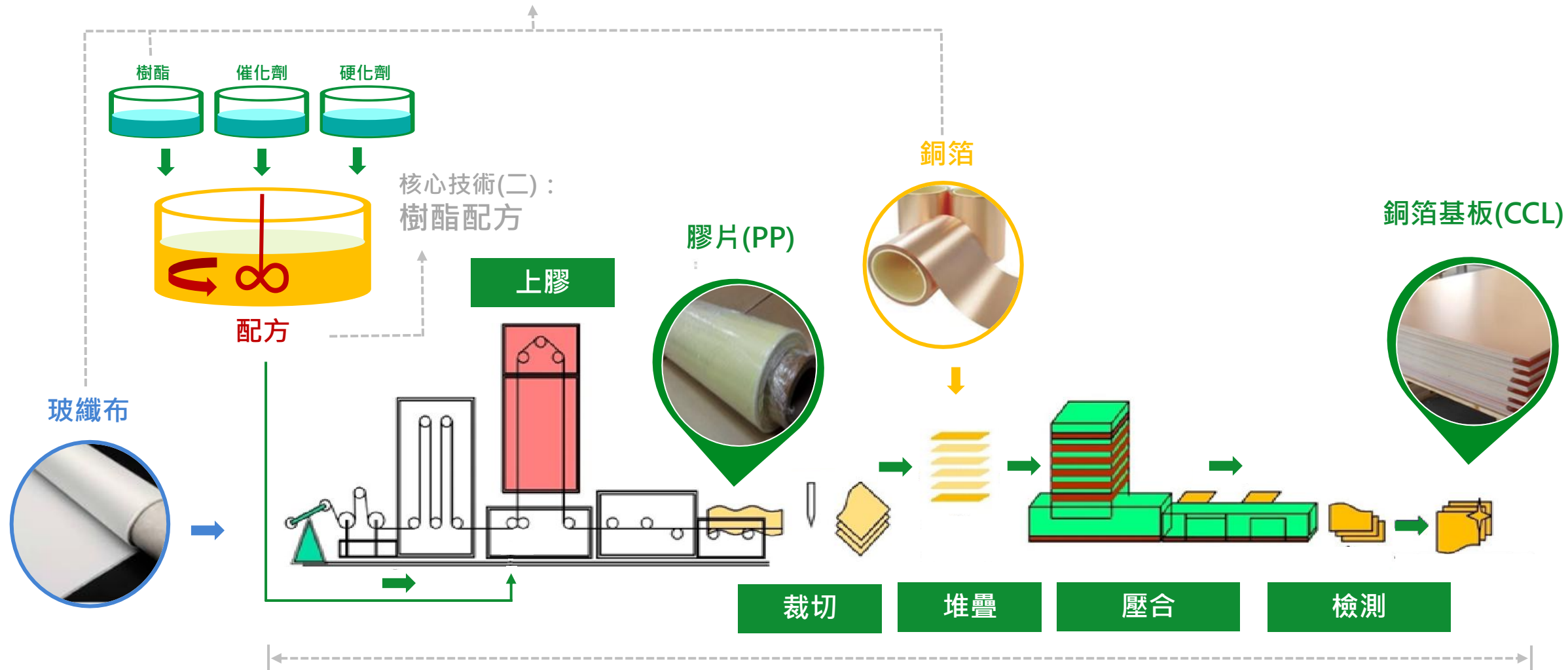
Question and Comment



補充附錄

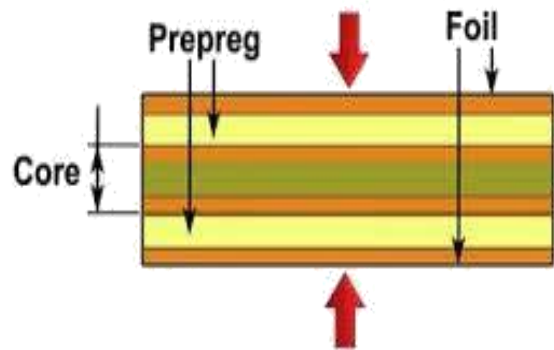
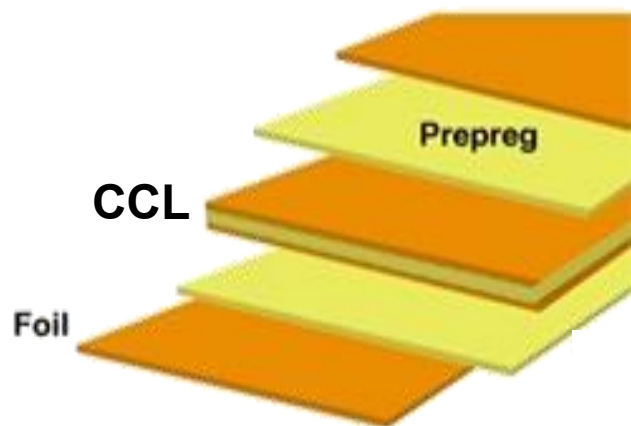
ITEQ

核心技術(一)：材料科學

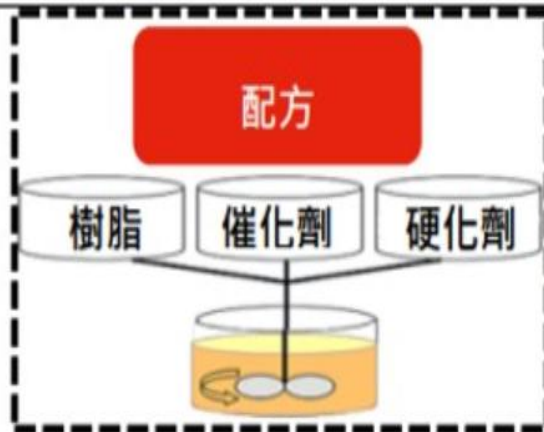


核心技術(三)：製程優化

CCL/PP



CCL 製程圖



玻纖布



銅箔基板



銅箔



PP 黏合



AI伺服器CPU*2主板
(產值-中)

(Used in both general type server and AI server)
CPU主板

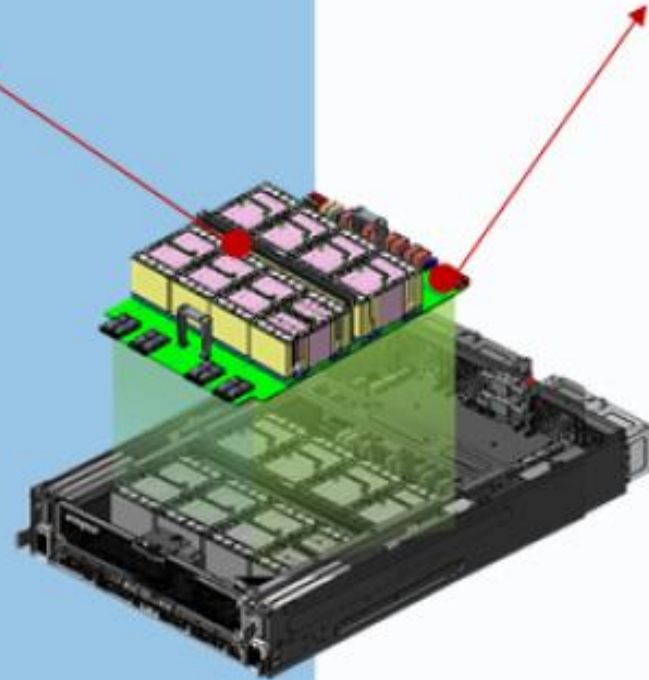


CCL : Very Low Loss 材料
板層數 : 14~24層

AI伺服器GPU OAM加速卡*8
(產值-高)

(Used in accelerator card— AI server only)

GPU Tray



CCL : Very Low Loss 材料
板層數 : 20~30層 (HDI)

AI伺服器GPU UBB底板
(產值-高)

(Used as GPU board— AI server only)

CCL : Ultra Low Loss / VLL 材料
板層數 : 20~30層 (含HDI)